

【精密定位與 AOI 對位技術實務】

台灣半導體產業年產值約新台幣1.8兆元；而2019年國內半導體產業設備採購需求5000億，其中前段製程設備比重佔70%，而向國內採購之設備僅佔15%，其中採購國內前段製程設備更僅有7%。2018年台灣工具機製造業產值達約9500億，平均毛利率15%；相對於半導體設備產業平均毛利率40-50%，前段製程高階機台毛利率甚至高於70%-80%，兩者差異甚大。

次微米(Sub micron)等級精度是設備共同世代所趨，其差異在於半導體製程特殊性及精密定位與製程對位需求；XY軸次微米級定位搭配Z軸奈米級短行程定位建構半導體製程技術基礎，對準(alignment) 與疊對(overlay) 製程需求建構半導體製程精度基礎。課程從精密定位與AOI對位技術需求講起，定位精度與整定時間要求、對位技術與6自由度關係，到次微米級設備組裝技術與限制條件，藉由振動抑制功能、精度的提昇，達到半導體設備精密定位與前後段製程對位的目標。

☆因應 COVID-19 疫情考量，本課程同時規劃「**線上同步數位學習**」形式，讓學員能在所在地進行線上學習，防疫不停學，隨時隨地學習、增進專業能力！

✦ 課程內容：

日期	課程大綱	講師簡介-陳講師(設計實務專家)
1/13 (四)	(1) 精密定位與 AOI 對位技術需求 (2) 定位精度與整定時間 (3) 振動等級與振動抑制需求 (4) 微米級設備 AOI 對位要項	經歷： 半導體設備廠資深技術副理、工研院經理 專長： 半導體設備設計、工具機設計、機器人設計
1/14 (五)	(1) 精密設備組裝技術與限制 (2) 對位技術與 6 自由度關係 (3) 前段製程設備精密定位技術 (4) 後段製程設備對位技術	著作與證照： 1. 半導體設備之精密對位技術 2. 多軸動態鏡面追蹤雙回饋量測補償技術 3. 半導體研磨設備之大尺寸氣靜壓主軸技術 4. 鏡面微結構超精密加工設備技術 5. 智慧結構多軸次微米主動抑振模組技術

【課程辦理資訊】

- 課程時間：111年1月13日、1月14日(四、五)·09:30~16:30·兩天共12hrs。
- 課程地點：工研院產業學院 產業人才訓練一部(台北)。實際地點依上課通知為準!
- 課程費用：

方 案	一般報名 (原價)	早鳥優惠價 需課前10日報名且繳費	團體優惠價	同步線上課程優惠價 (個人&團體報名皆適用)
	價 格	8,000元/人	7,200元/人	7,200元/人

- 報名方式：傳真或線上報名<http://college.itri.org.tw>
- 課程聯絡人：(02)2370-1111 分機 316 李小姐、分機 309 徐小姐

報 名 表

FAXTO：(02)2381-1000 李小姐收

課程名稱：精密定位與對位技術實務				
公司全銜			統一編號	
發票地址			傳 真	
參加者姓名	部 門	電 話	手 機	E-mail
		()		
		()		
聯 絡 人		()		

信用卡 (線上報名)：繳費方式選「信用卡」，直到顯示「您已完成報名手續」為止，才確實完成繳費。
 ATM 轉帳 (線上報名)：繳費方式選擇「ATM 轉帳」者，系統將給您一組轉帳帳號「銀行代號、轉帳帳號」，但此帳號只提供本課程轉帳使用，各別學員轉帳請使用不同轉帳帳號！！轉帳後，寫上您的「公司全銜、課程名稱、姓名、聯絡電話」與「收據」回傳。
 銀行匯款(公司逕行電匯付款)：土地銀行 工研院分行，帳號 156-005-00002-5 (土銀代碼：005)。戶名「財團法人工業技術研究院」，請填具「報名表」與「收據」回傳。
 即期支票：抬頭「財團法人工業技術研究院」，郵寄至：100 台北市中正區館前路 65 號 7 樓 704 室，李小姐收
 計畫代號扣款(工研院同仁)：工研院員工報名請網路點選「工研人報名」填寫計畫代號後，經主管簽核同意即可

- 1、請註明服務機關之完整抬頭，以利開立收據；未註明者，一律開立個人抬頭，恕不接受更換發票之要求。
- 2、若報名者不克參加者，可指派其他人參加，並於開課前一日通知。
- 3、如需取消報名，請於開課前三日以書面傳真至主辦單位並電話確認申請退費事宜。逾期將郵寄講義，恕不退費